

Singulation System

Model FMS3040-FC



Singulation system for cutting substrates

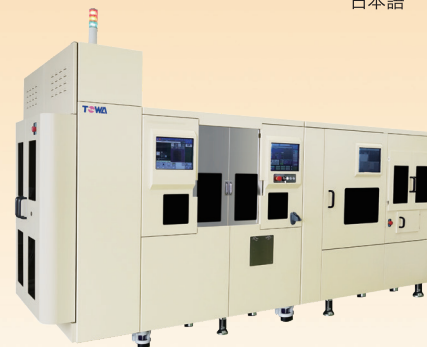
基板カット専用シンギュレーション装置

- カットから洗浄・乾燥、外観検査、トレイ収納までのプロセスを1台で全自動対応
- フリップチップ基板のカットに対応
- 最大W242 × L322.5 × t2.5mmサイズの基板対応
- 顧客ニーズに合わせた最適なジグダイサー&ハンドラーで高精度カットを実現
- 外観検査機能を標準搭載 基板厚みに応じたオートフォーカス対応

製品情報



日本語



SPECIFICATION

Items		Unit	Description	
モデル		—	FMS3040-FC	
装置区分		—	Tray type	
ワークサイズ	長さ	mm	267.2—322.5	
	幅	mm	150—242	
	厚み	mm	0.6—2.5	
パッケージサイズ	最小	mm	12×12	
	最大	mm	60×60	
基板反り量		—	2mm/200mm (Max.)	
ダイサー		—	Twin spindles, Twin tables	
外形寸法	モジュール	module	Cut Engine	Offload
	幅	mm	2,255	1,625
	奥行き	mm	1,760	1,760
	高さ	mm	2,200	1,800
重量		ton	5.4	
ワーク供給部	タイプ	—	スリットマガジン	
	数量	pcs	2 (Max.) マガジン幅320mmの場合	
製品収納部	タイプ	—	JEDEC Tray	
	数量	pcs	50 (Max.)	
ピック&プレイスヘッド数		—	2units×7pcs (Option: 2units×11pcs)	
キット交換時間		min	15	
製品搬送方式		—	Vacuum	
製品処理能力		UPH	730	

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社

〒601-8105

京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.

台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.

韓国
TOWA Korea Co., Ltd.

シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

ドイツ
TOWA Europe GmbH

オランダ
TOWA Europe B.V.

アメリカ
TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ